

露笑科技股份有限公司
关于完成合肥露笑半导体材料有限公司
工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月19日披露了《关于与长丰县签订投资合作协议的进展公告》，公司与合肥北城资本管理有限公司、长丰四面体新材料科技中心（有限合伙）签署了《合资协议》，协议约定三方合作在安徽省合肥市长丰县投资建设“第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目”（下称“项目”），并共同出资设立一家有限责任公司作为本项目的公司，注册资本为2亿元人民币。

公司于近日完成全资子公司合肥露笑半导体材料有限公司的工商注册登记手续，并取得了长丰县市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：

公司名称：合肥露笑半导体材料有限公司

统一社会信用代码：91330681MA2D83G9X0

类型：其他有限责任公司

住所：安徽省合肥市长丰县双凤工业区双凤路598号

法定代表人：蒋隰

注册资本：人民币2亿元整

成立日期：2020年10月27日

营业期限：2020年10月27日至长期

经营范围：半导体器件专用设备制造；半导体材料生产设备制造；半导体级硅单晶生长、晶片切割、磨抛、清洗设备制造；半导体分立器件制造；电子半导体材料制造；从事半导体材料的制造、加工、销售及技术咨询、技术转让、技术服务；从事与电子科技、信息科技相关的材料的制造、加工、销售及咨询服务；半导体新材料研发；半导体设备的研发、制造和销售；自营和代理各类商

品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司将按计划在近期完成项目公司土地、厂房建设，同步推进设备购置，力争明年6月底前完成一期碳化硅衬底片产能建设并达产。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十七日